

# Technisches Merkblatt HECK K+A

**HECK K+A:** Werk trockenmörtel mit PWS-Technologie, mineralischer Klebe- und Armierungsspachtel, GP, CS IV, W 2 nach DIN EN 998-1 (P III nach DIN V 18 550)

**Eigenschaften:**

- von Hand aber auch mit Putzmaschinen und Förderanlagen zu verarbeiten
- wasserdampfdiffusionsoffen und wasserabweisend
- faserarmiert
- filzbar
- Farbtöne: weiß, grau

**Anwendungsbereich:**

- für Außen- und Innenbereich, sockeltauglich
- zum Kleben und Armieren von Dämmplatten in HECK Dämmsystemen EPS und MW/L-MW
  - zum Armieren und anschließendem Filzen in einer zweiten Schicht
  - zum Glätten und Verspachteln geeigneter mineralischer Untergründe

Auch zum Ansetzen der Eck- und Diagonalarmierungen geeignet. Die Regelauftragsdicken müssen eingehalten werden. Dies gilt auch für den Bereich der Eckarmierungen.

Anwendung in Wärmedämm-Verbundsystemen:

- als **dünnschichtiger Armierungsspachtel** (3-6 mm) mit Einbettung von HECK AGG FINE (Armierungsgewebe fein)
- als **dickschichtiger Armierungsspachtel** (7-10 mm) mit Einbettung von HECK AGG FINE (Armierungsgewebe fein) bzw. in HECK Keramiksystemen mit HECK AGG CER (Armierungsgewebe Keramik)
- als dünne filzbare Schicht (Schichtdicke ca. 2 mm) in einem 2. Arbeitsgang bei Kleinflächen, wie z. B. im Sockelbereich

Anwendung bei Fassadensanierungen:

- als Armierungsspachtel (3-5 mm) auf Beton und festen, tragfähigen, mineralischen Putzen CS III und IV nach DIN EN 998-1 (P II, III nach DIN V 18 550) mit HECK AGG FINE (Armierungsgewebe fein). Für darüber hinausgehende Verwendungen haftet der Anwender selbst.

**Zusammensetzung:**

Weißkalkhydrat, Zement, sorgfältig zusammengesetzte Zuschläge, Zusatzmittel zur Verbesserung der Verarbeitbarkeit, Haftfestigkeit und Wasserabweisung sowie Fasern

**Technische Daten:**

Rechenwert zur Wärmeleitfähigkeit $\lambda_R$ :	0,87 W/(m·K)
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl $\mu$ :	ca. 25
Größtkorn:	ca. 1,0 mm

**Verbrauch:**

**Kleben:**

Punktverklebung (Schienensystem):	<b>ca. 2 kg/m<sup>2</sup></b>
Wulst-Punkt-Verklebung (mind. 40%) / vollflächige Verklebung:	<b>ca. 4 kg/m<sup>2</sup></b>
Teilflächenverklebung*:	<b>ca. 6 kg/m<sup>2</sup></b>
Vollverklebung*:	<b>ca. 8 kg/m<sup>2</sup></b>

Die Angaben gelten für ebene, glatte Untergründe. Beim Ausgleich von Unebenheiten Mehrverbrauch möglich!

\*Kleberauftrag auf das Mauerwerk

**Spachtel und Armierungsmörtel:**

ca. 1,2 kg Trockenmörtel / m<sup>2</sup> je mm Schichtdicke  
Bei maschineller Verarbeitung Mehrverbrauch möglich!

**Putzgrund/  
Putzgrundvorbereitung:**

Arbeitsbereich unbedingt vor Beginn der Arbeiten gut abdecken.

Kleben der Dämmplatten und Spachteln auf mineralischem Untergrund:  
Der Untergrund muss eben, tragfähig, sauber, trocken, fett- und staubfrei sein. Eine Reinigung wird empfohlen. Mürber oder hohl liegender Putz oder lose anhaftende Farbreste sowie Algen sind grundsätzlich zu entfernen.

Hohlfugen, Mauerwerksfehlstellen und größere Vertiefungen vor dem eigentlichen Kleber- bzw. Putzauftrag egalalisieren, oberflächenbündig abziehen und während des Ansteifens aufkämmen und erhärten lassen. Oberflächlich sandende, kreidende, stark saugende, organisch gebundene Untergründe einmal mit Rajasil TG W (Tiefengrund W) vorbehandeln.

Armieren auf Dämmplatten:

Die Dämmplatten müssen eben verlegt sein, offene Dämmplattenfugen müssen mit gleichwertigem Dämmstoff oder HECK PU-Schaum B1 geschlossen sein, evtl. Schleifstaub muss entfernt sein. Profile, Dübel, Fugendichtbänder und Anputzleisten müssen gesetzt sein, ebenso die Eck- und Diagonalarmierungen.

Ein Untergrundaussgleich mit der eigentlichen Armierungsschicht ist nicht zulässig.

---

**Verarbeitungs-  
und Untergrundtemp.:**

mindestens + 5 °C. Ein Unterschreiten der Temperaturen während der Erhärtungsphase kann die Produkteigenschaften nachhaltig ungünstig beeinflussen.

---

**Verarbeitung:**

Bei hohen Temperaturen (und/oder Windbelastung) sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich, um zu schnellen Anmachwasserentzug zu verhindern.  
Den Inhalt eines Sackes mit der erforderlichen Menge Leitungswasser in einem sauberen Mörtelkübel mit einem Motorquirl knollenfrei anrühren, ca. 10 Minuten reifen lassen, vor dem Auftragen nochmals gut durchmischen und innerhalb von ca. 1 Stunde verarbeiten.

**Kleben:**

Bei unbeschichteten MW-Dämmplatten ist der Klebemörtel vorher dünn unter Druck vorzuziehen (sog. Pressspachtelung).  
Der Klebemörtel ist dann mittels Zahntraufel (10 mm) bzw. Kelle oder mit der Klebepistole auf der Dämmplattenrückseite aufzutragen, beim teil- oder vollflächigen Klebeverfahren auf das Mauerwerk zu spritzen.  
Bei Klebearbeiten im Deckenbereich sind Vorversuche erforderlich. Es ist hierbei festzustellen, ob zusätzliche Maßnahmen, wie z. B. eine Dübelung oder ein Abstützen bis zum Erhärten, erforderlich sind.

**Armieren:**

Der Mörtel wird mit einer rostfreien Stahltraufel in entsprechender Dicke auf die (trockenen) Dämmplatten aufgebracht. Anschließend wird das HECK AGG (Armierungsgewebe) im oberen Drittel eingebettet (Gewebeüberlappung mind. 10 cm), ggf. wird nochmals nachgespachtelt. Für den nachfolgenden Auftrag dünnlagiger Oberputze wird die Oberfläche mit der Edelstahltraufel eben abgezogen.  
Für nachfolgendes Filzen wird der Untergrund so belassen. Für dicklagige Edelputze erfolgt ein Aufrauen der Oberfläche, ohne das Gewebe freizulegen. Das Aufrauen darf erst nach Bildung der Sinterhaut erfolgen.

**Gefilzte Oberflächen:**

Auf die vorbereitete Armierungsschicht wird am folgenden Tag HECK K+A in einer ca. 2 mm dicken Schicht mit der Edelstahltraufel aufgebracht, eben abgezogen und während des Ansteifens, vorzugsweise mit dem weißen Schwammbrett, abgefilzt.

---

**Nachbehandlung:**

Der frische Mörtel muss vor zu schnellem Wasserentzug (Sonne, Wind, hohe Temperaturen), Frosteinwirkung und Regen geschützt werden. Beim Verkleben ist dieser vor einer Hinterfeuchtung zu schützen.

---

**Oberflächen-  
beschichtung:**

Mit HECK Oberputzen (Rajasil EP WD, HECK EP KR JURA, HECK ED, HECK STR, HECK SIP, HECK SHP), HECK Flachverblendern oder geeigneten keramischen Bekleidungen.  
Vor nachfolgenden Beschichtungen ist je nach Oberputz die ggf. zugehörige Grundierung zu verarbeiten. Standzeit vor Grundierung bzw. Oberputz oder der gewünschten keramischen Bekleidung: je nach Witterung mind. 1 Tag je mm Schichtdicke.

**Im Sockelbereich:**

- Rajasil Siliconharzfarbsystem, bestehend aus zweimaliger Grundierung mit Rajasil NIG (Nano Imprägnierung und Grundierung) und zweimaligem Anstrich mit Rajasil SHF (Siliconharzfarbe).
- HECK SHP (Siliconharzputz) einschl. der dazugehörigen Grundierung.

Das in den Perimeterbereich einbindende Putzsystem ist gegen eine Hinterfeuchtung zu schützen. Hierzu ist Rajasil DB (Dickbeschichtung) oder Rajasil DS FLEX (Dichtungsschlämme flexibel) zu verwenden.

---

**Hinweise:**

Bitte technische Richtlinien „Verarbeitungsrichtlinien HECK“ bzw. ergänzende Merkblätter relevanter Produkte beachten.  
Beim Verputzen von EPS-Platten mit Oberflächenwaffelung (Rille) ist der Mörtel zweischichtig aufzubringen. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.  
Bei der Herstellung von WDV-Systemen sind die jeweils gültigen bauaufsichtlichen Zulassungen zu beachten. Diese sind auf Anfrage kostenfrei bei uns zu beziehen.

---

**Sicherheitshinweise:**

HECK K+A enthält Kalk und Zement, frischer Mörtel reagiert daher alkalisch. Kontakt mit der Haut vermeiden, Spritzer sofort abwaschen. Bei Kontakt mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen und Arzt aufsuchen. Das Material darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken unverzüglich Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe tragen. Weitere Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt.

---

**Lagerung:**

trocken, Lagerdauer ca. 9 Monate im Originalgebinde.

---

**Qualitätskontrolle:**

laufende labormäßige Überwachung der Produktion, regelmäßige Eigen- und Fremdüberwachung

---



Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Der Abnehmer ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch dafür qualifiziertes Personal nicht befreit. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus. Mit dieser Ausgabe sind die früheren Technischen Merkblätter ungültig.

**HECK Wall Systems GmbH**  
Thölauer Straße 25  
95615 Marktredwitz / Germany  
T: +49 9231 802-330  
F: +49 9231 802-330  
[www.wall-systems.com](http://www.wall-systems.com)